



個人投資家様向け 株式会社エノモト

会社説明資料

2022年12月14日

ENOMOTO Co.,Ltd.

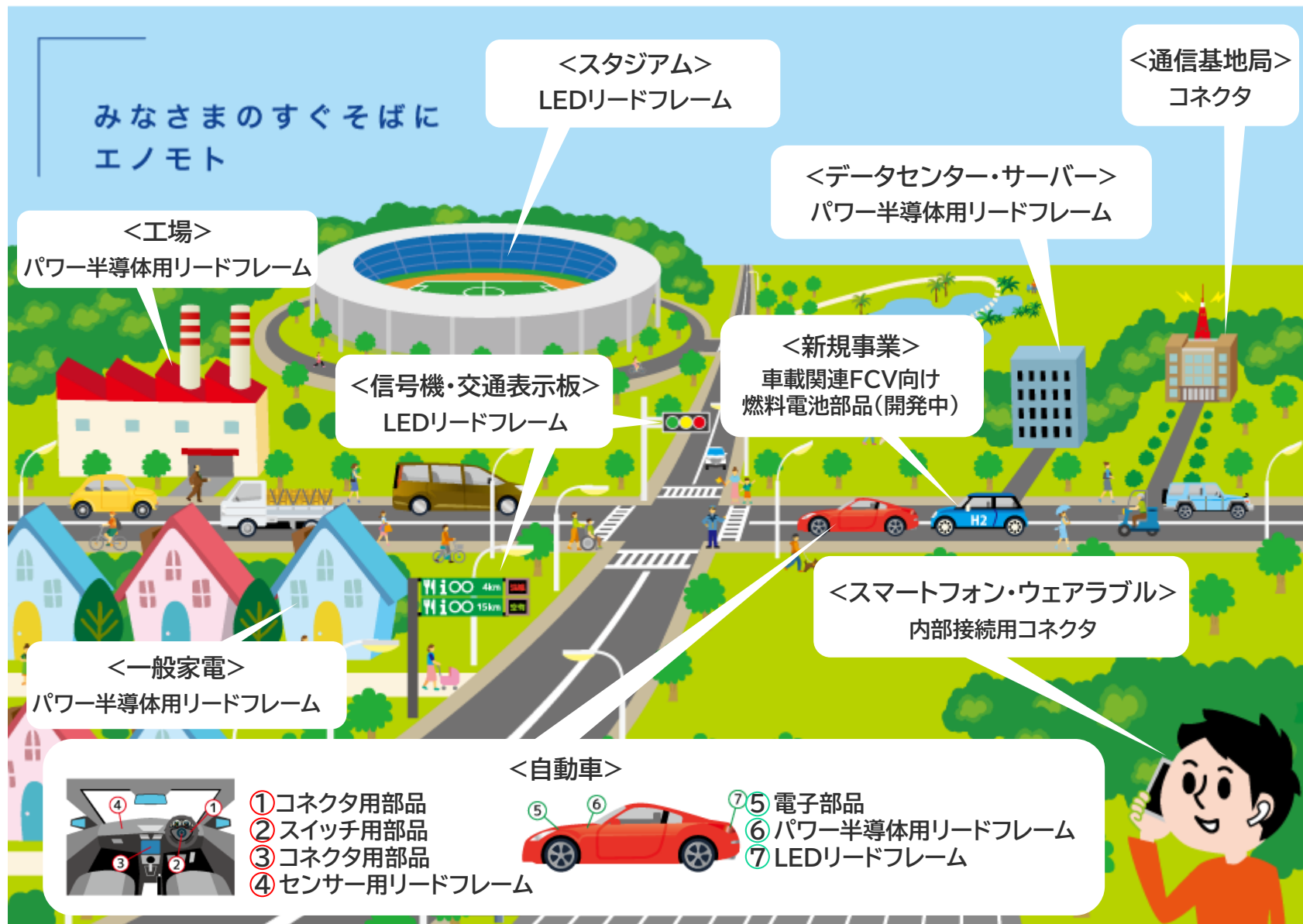
東証プライム 証券コード:6928

(1) 会社概要	P. 3
(2) 2023年3月期第2四半期決算	P.20
(3) 2023年3月期業績予想	P.26
(4) 中期経営計画の進捗	P.29
(5) 中期環境計画(SDGsへの取り組み)	P.39
参考資料	P.45

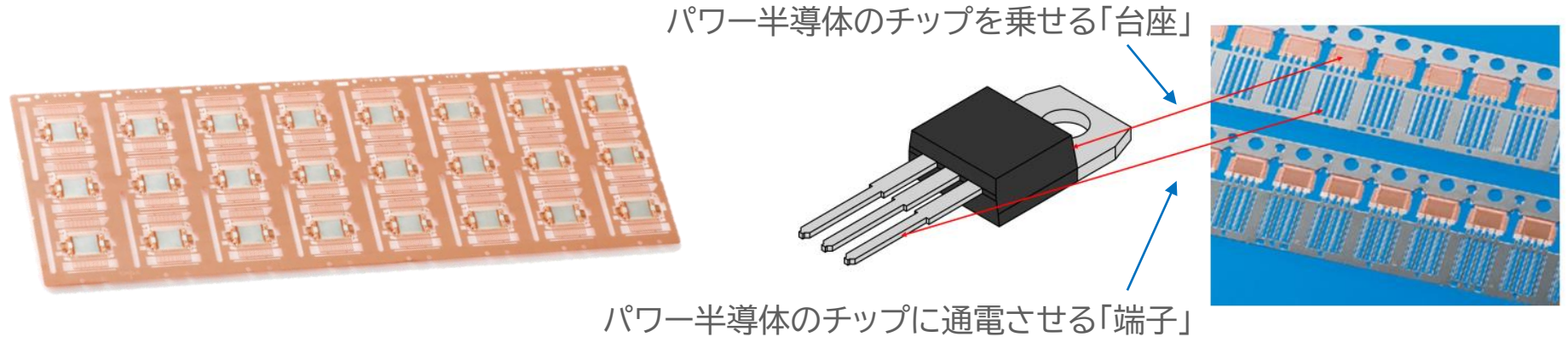
1. 会社概要



社名	株式会社 エノモト ENOMOTO Co.,Ltd.
設立	1967年4月(創業 1962年7月)
代表取締役社長	武内 延公
本社所在地	山梨県上野原市上野原8154-19 TEL : 0554-62-5111
生産拠点	本社工場:山梨県甲州市／山梨県上野原市 津軽工場:青森県五所川原市 岩手工場:岩手県上閉伊郡大槌町 技術部 :山梨県甲州市 エノモトフィリピン:フィリピン カビテ州 (連結子会社) 中山エノモト:中国 広東省 中山市 (連結子会社)
資本金	4,749百万円
従業員数 (2022年3月31日現在)	国内 :499人 ※国内従業員 平均年齢 41.6歳 フィリピン:526人 中国 :239人
事業内容	(1).各種半導体用部品(リードフレーム)及びコネクタ用部品製造、販売 (2).プレス金型及びインサート成形金型の開発、設計、製作

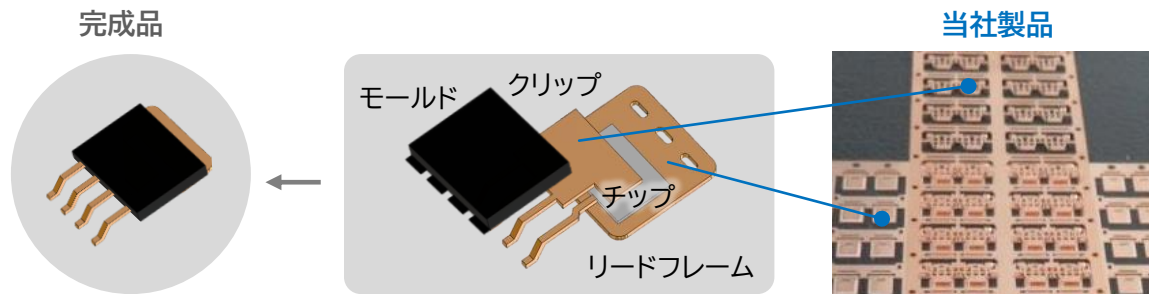


従来型のパワー半導体用リードフレーム



クリップボンディング方式パワー半導体用リードフレーム

- 車載ECU*1や産業機器向けパワー半導体の高電圧・高電流化に伴い、従来のリードフレームを上回る高信頼性と省スペース化の要求から接触面積が大きく、通電容量の高いクリップボンディング*2の注目が高まる



- クリップとリードフレームでチップを挟み込むため大きな面で接続でき、電気特性と熱特性が高まる
- 平坦度が低いと非接触部分ができパワー半導体の電流量が低下

高耐熱性

長寿命化

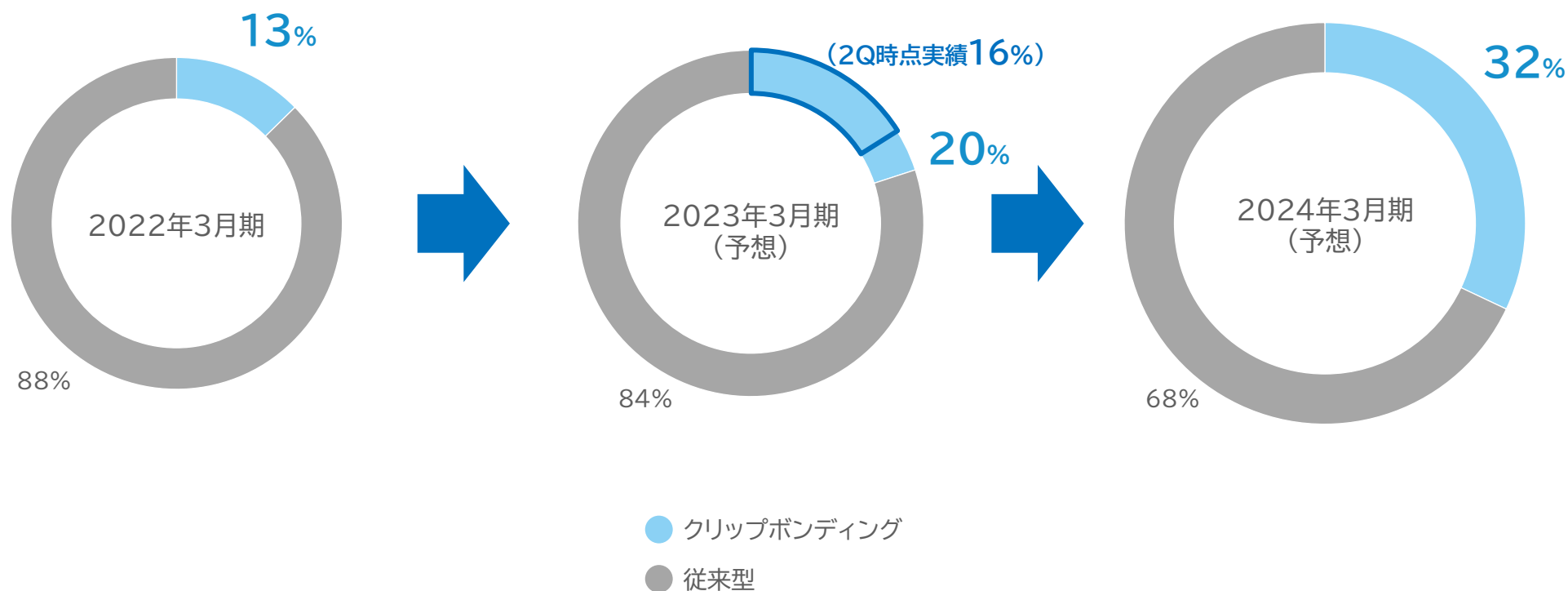
平坦度・清浄度・位置精度の要求が高く、高い付加価値率、他社に先駆けて本格量産開始

*1 ECU Electronic Control Unit

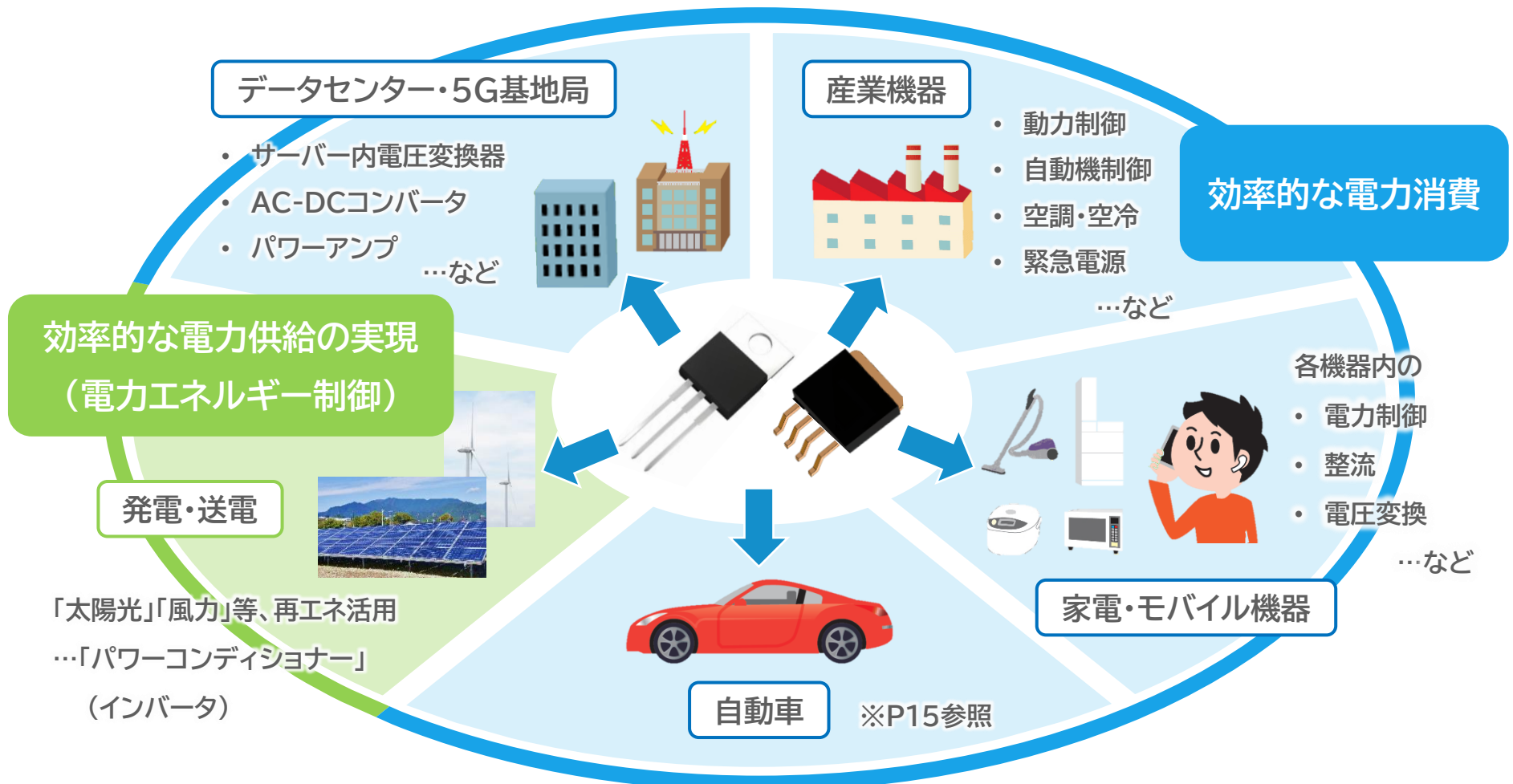
*2 クリップボンディング ワイヤレスボンディングから表記を変更

- 当社内のパワー半導体用リードフレームに占めるクリップボンディングリードフレームの売上構成比率は2022年3月期の13%から、2024年3月期に32%まで上昇する見通し
- 当社はクリップボンディングリードフレームの量産で先行し、従来型リードフレームに比べて付加価値も高いクリップボンディングの市場拡大により、リードフレーム事業の売上拡大と利益率改善を目指す

パワー半導体用リードフレームに占めるクリップボンディングリードフレームの構成比



- 環境側面からも、新たな発電技術の開発・発展、高効率な電力供給を支える高機能パワー半導体に注目が集まる
- SiC・GaNパワー半導体を使うことで、高電圧・高電流化に加え低損失を実現し、高出力・省エネに寄与

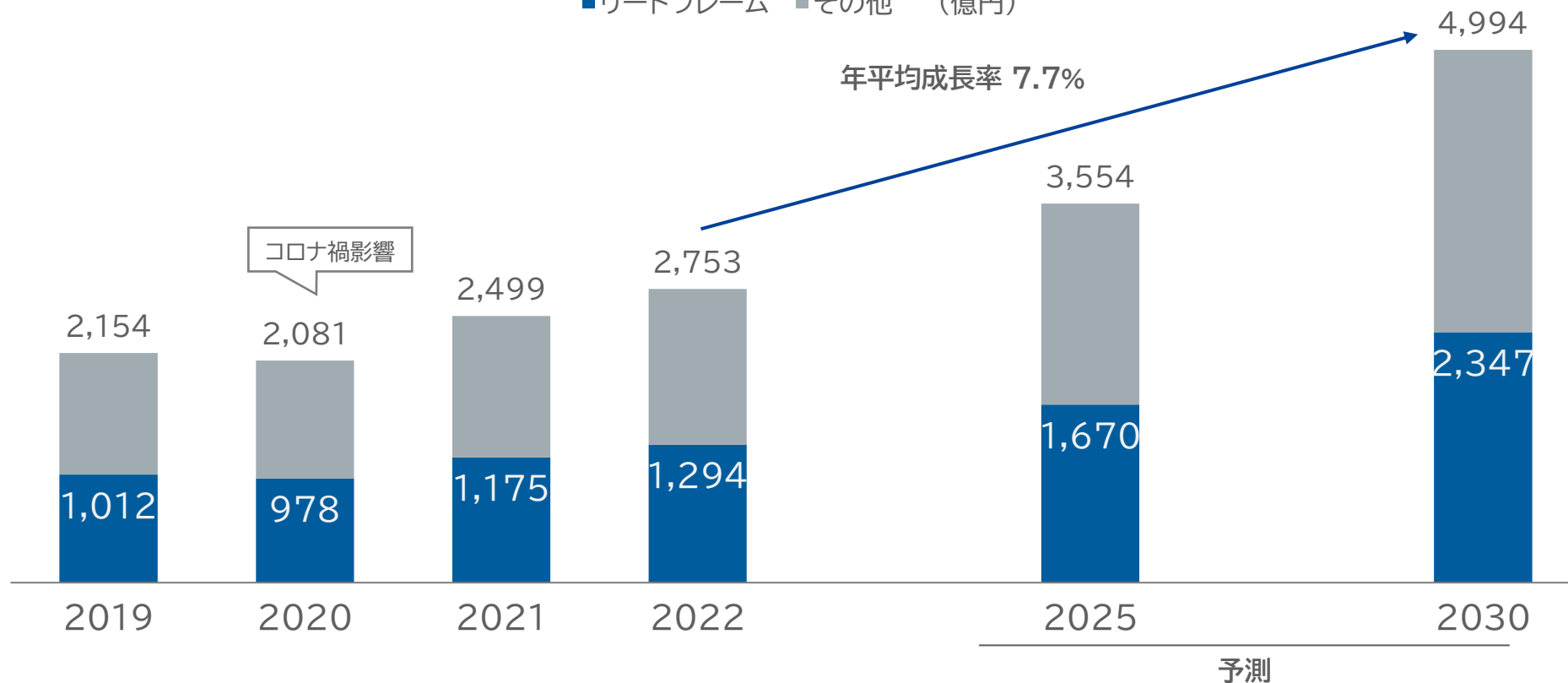


* SiCはSilicon Carbide(炭化ケイ素)、GaNはGallium Nitride(窒化ガリウム)の略

- ・ リードフレームを含むパワー半導体構成部材*は年平均7.7%成長、2030年には4,994億円へ前回予想の3,752億円から大幅に上方修正された
- ・ 構成部材のうち、約47%がリードフレームと推定

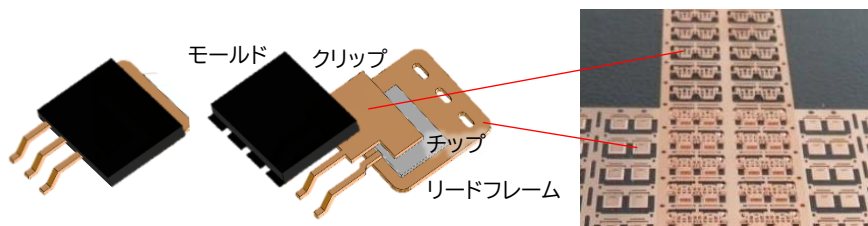
パワー半導体構成部材の市場予測

■ リードフレーム ■ その他 (億円)



* 構成部材の市場はパワー半導体市場の内訳
出所:富士経済「2022年版 次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望」

クリップボンディング方式パワー半導体用リードフレーム



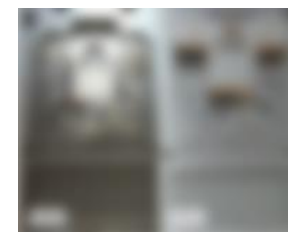
パワー半導体用
リードフレーム



IGBT用
リードフレーム



ICレギュレータ用
リードフレーム



- 上記部品が後工程を経てパワーデバイスモジュールを構成し、車載(制御系など)に使用される
- EV等の新エネルギー車向けで、クリップボンディング方式が適するSiCパワーデバイスの需要拡大
- 主に中国のEV向けに需要拡大

パワーデバイス適用製品

計**40**品種以上

パワートレイン制御

- モーター制御
- バッテリー
- インバータ
- ICレギュレータ
- オルタネータ
- トランスミッション制御
- ラジエーターファン制御



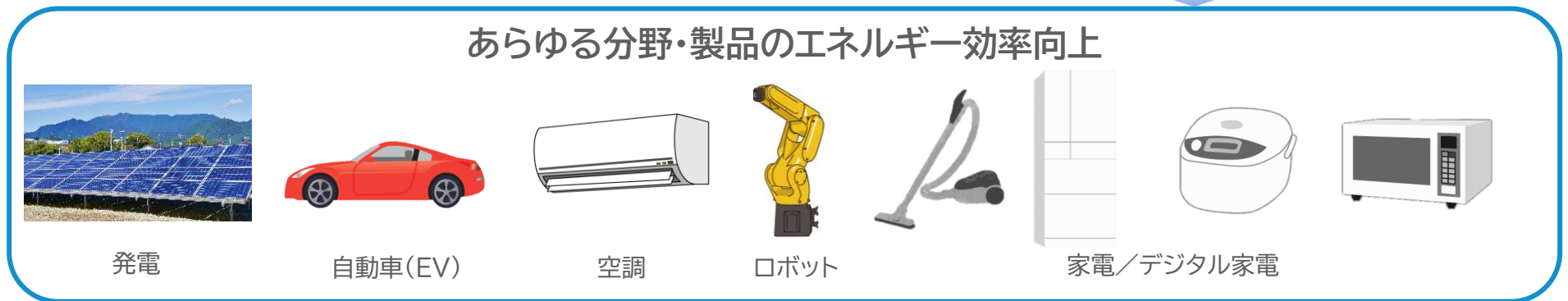
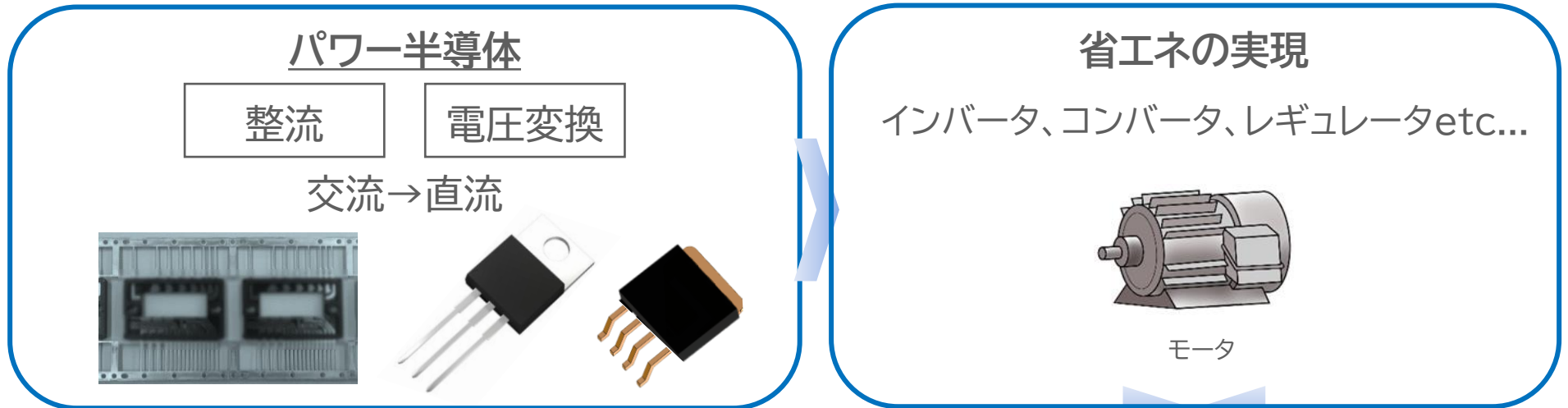
車両制御

- ステアリング制御
- クルーズ制御

ボディ制御

- パワーウィンドウ
- オートマチックドアロック
- 電動シート
- ライト制御
- ナビコン
- マイコンエアコン

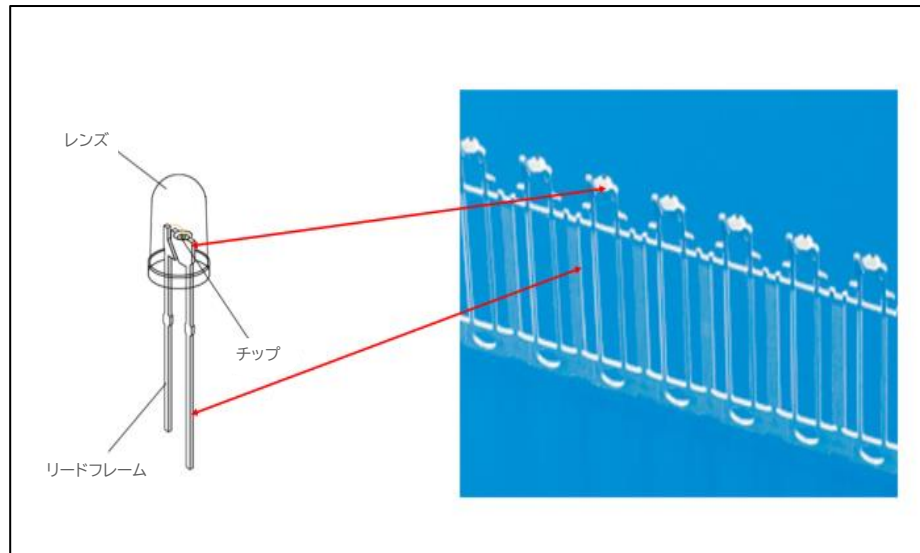
- 効率的な電力の変換や制御は全ての分野・製品で重要・・・高機能パワー半導体がキーデバイスとなる
- 世界の電力の50～60%はモータで消費している・・・**電力を効率よく制御するインバータ化は省エネの必須条件**



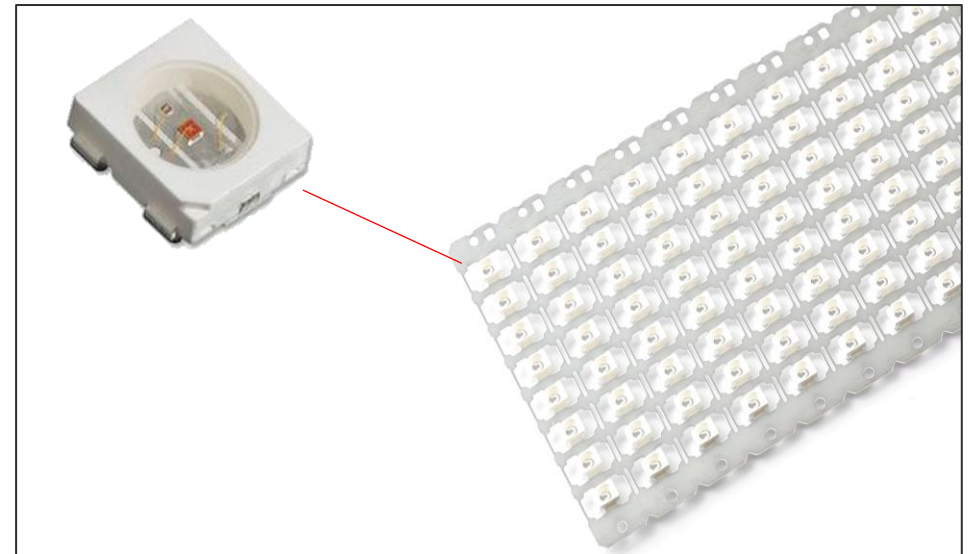
「温室効果ガス排出実質ゼロ」の実現へ
「GX」とは ... 「パワービジネス」

- 当社の販売先(LEDメーカー)でチップを乗せて光源となる
- チップを乗せる部分(カップ)の高い形成技術で、より鮮やかな輝きを作る
- 大きく分けて砲弾型と表面実装(SMD)の2種類
- 砲弾型のリードフレームを大量生産できる、国内唯一のメーカー

LED用リードフレーム(砲弾型)



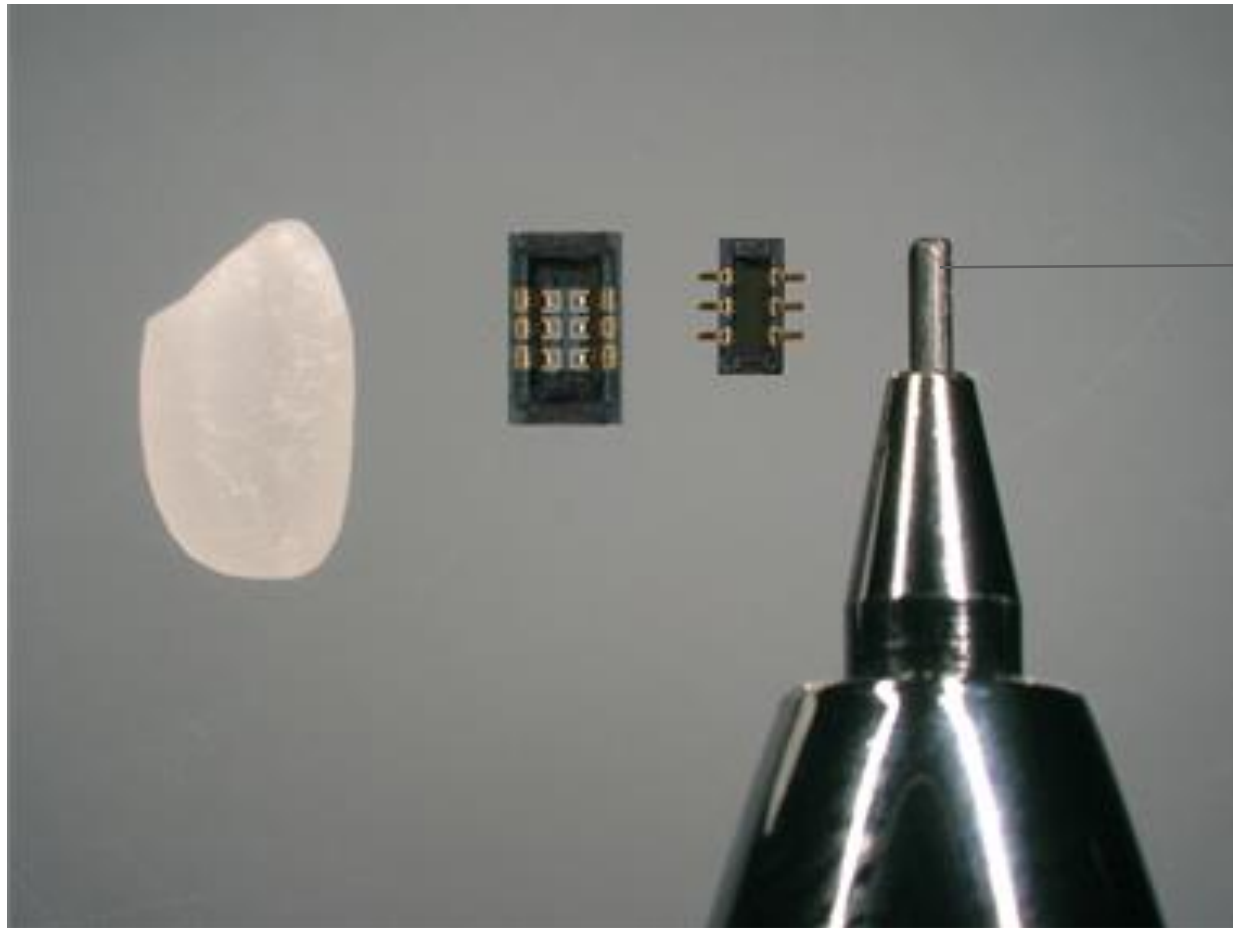
LED用リードフレーム(SMD)



- 世界最高水準の超精密コネクタ部品

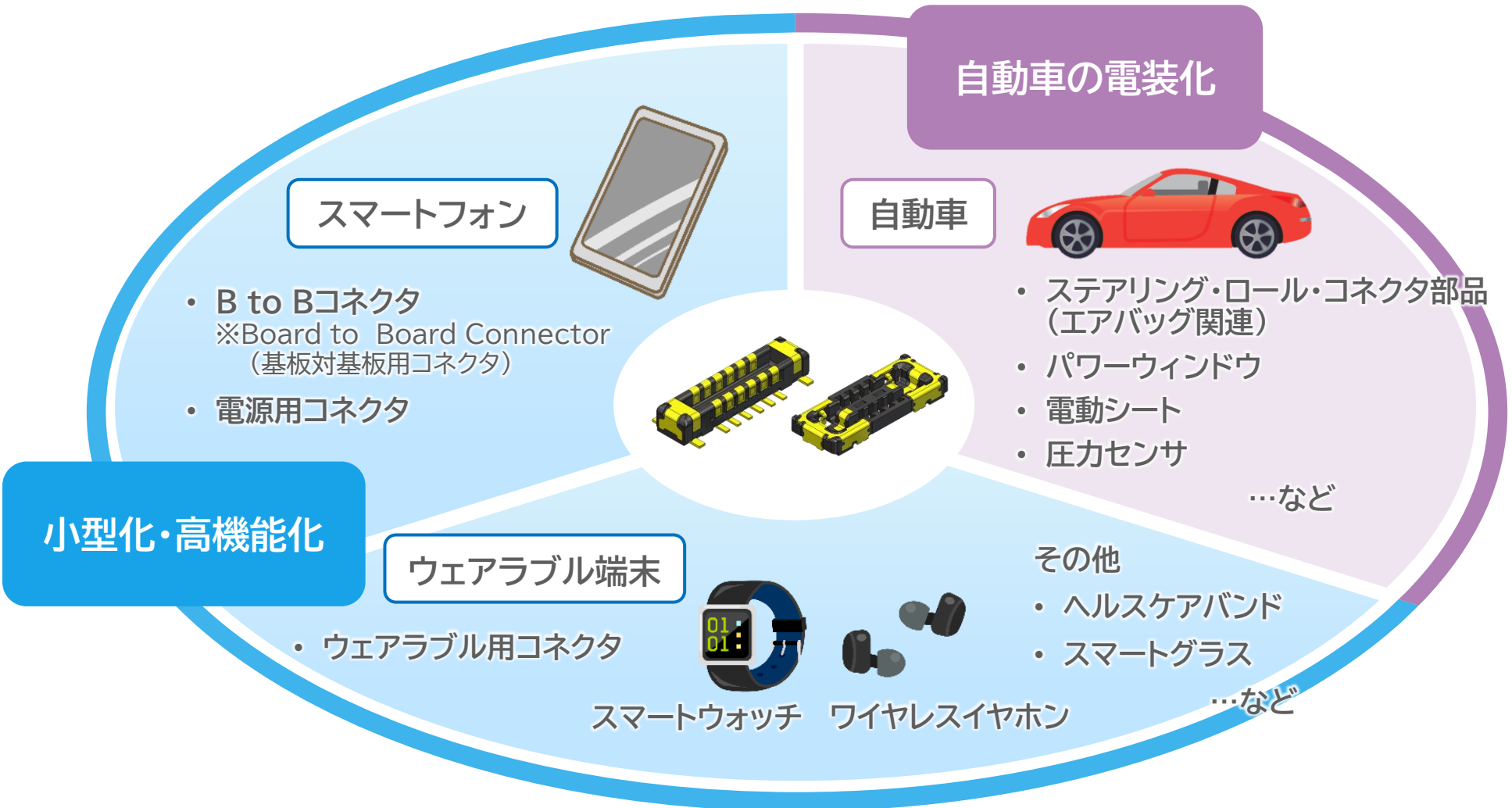
使用先…スマートフォン

ウェアラブルデバイス(スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン等)



シャープペンシル芯
(Φ 0.5mm)

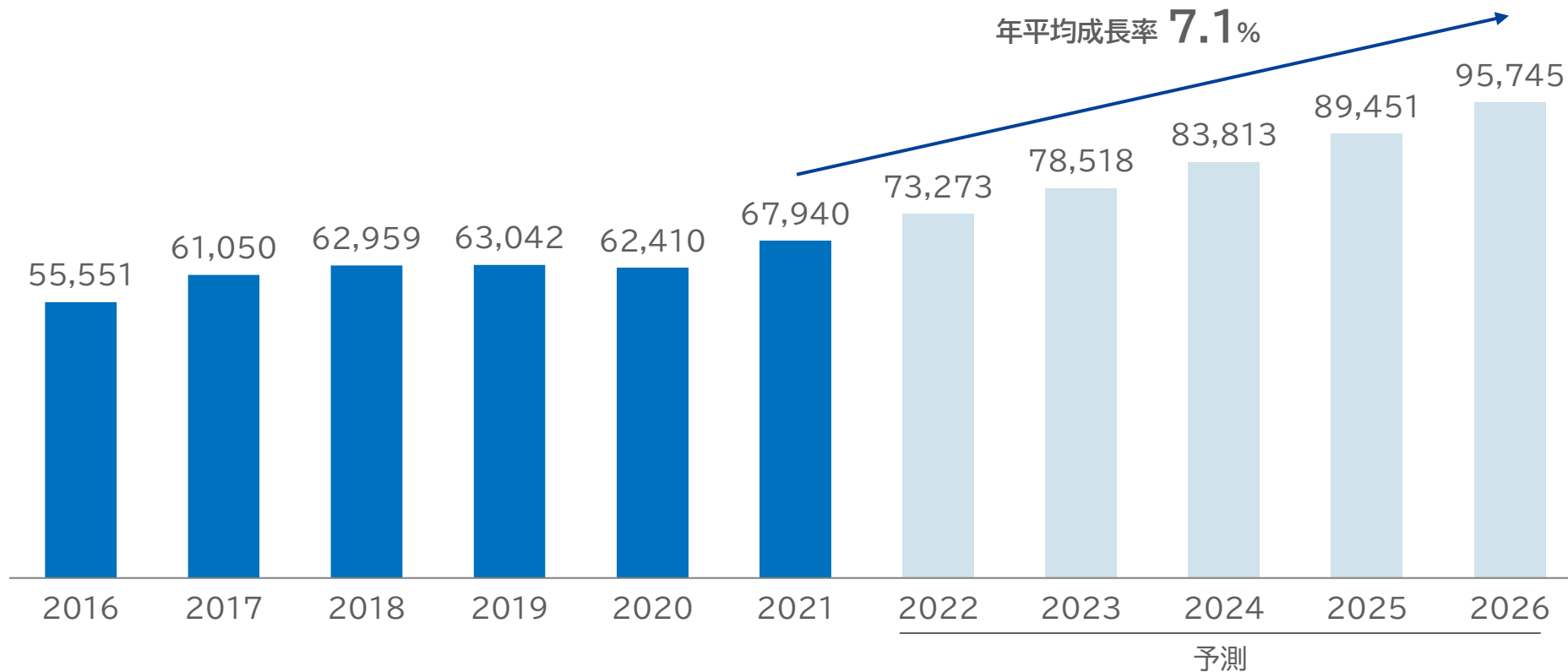
- スマートフォン・ウェアラブル端末向けの極小部品から、自動車向けの特殊で大きな部品まで幅広く対応
- 超微細な部品を高品質大量生産



- コネクタ市場も年平均7.1%の成長が続くと予想
- 2020年以降は車載向け部品の搭載率上昇、スマートフォンの高機能化やウェアラブル端末などのワイヤレス化が市場を牽引

コネクタ世界市場規模の推移と需要予測

単位:億円



出所:産業情報調査会「2021年版 コネクタ市場」

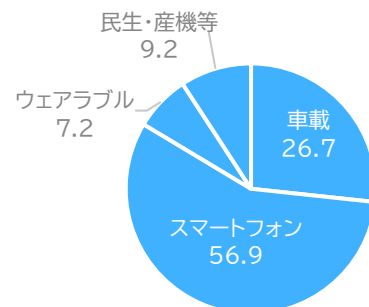
- ・ リードフレームでは車載や5G基地局向けなどにパワー半導体向け製品が伸長
- ・ コネクタ用部品ではスマートフォンやウェアラブル端末向けの狭ピッチ、低背製品が伸長
- ・ リードフレーム、コネクタ部品それぞれ約50%とバランスが取れた事業構成

その他

売上高 679百万円
前同比 $\Delta 1.4\%$
構成比 2.5%

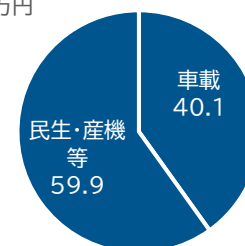
コネクタ用部品

売上高 12,955百万円
前同比 4.6%
構成比 47.5%



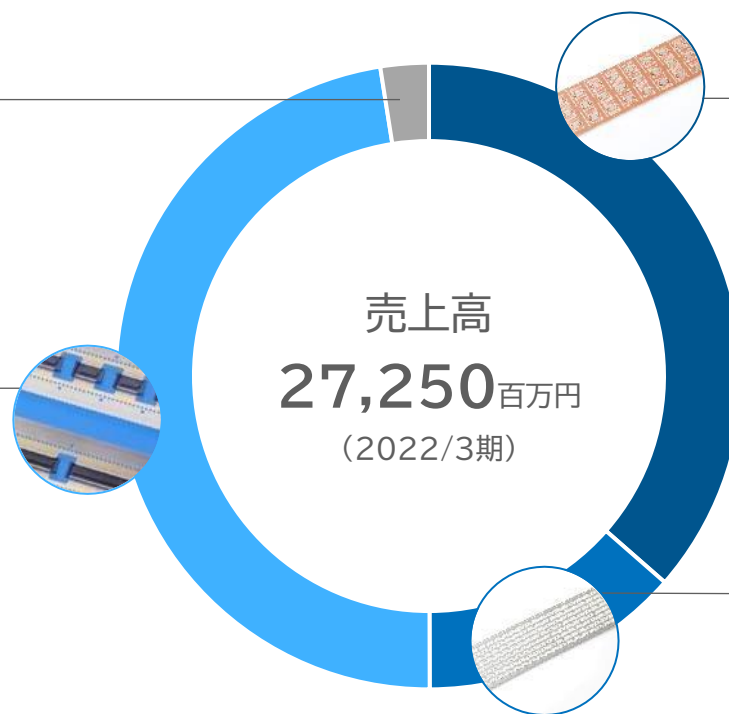
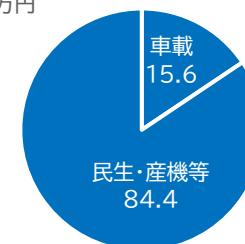
パワー半導体用リードフレーム

売上高 9,929百万円
前同比 36.3%
構成比 36.5%



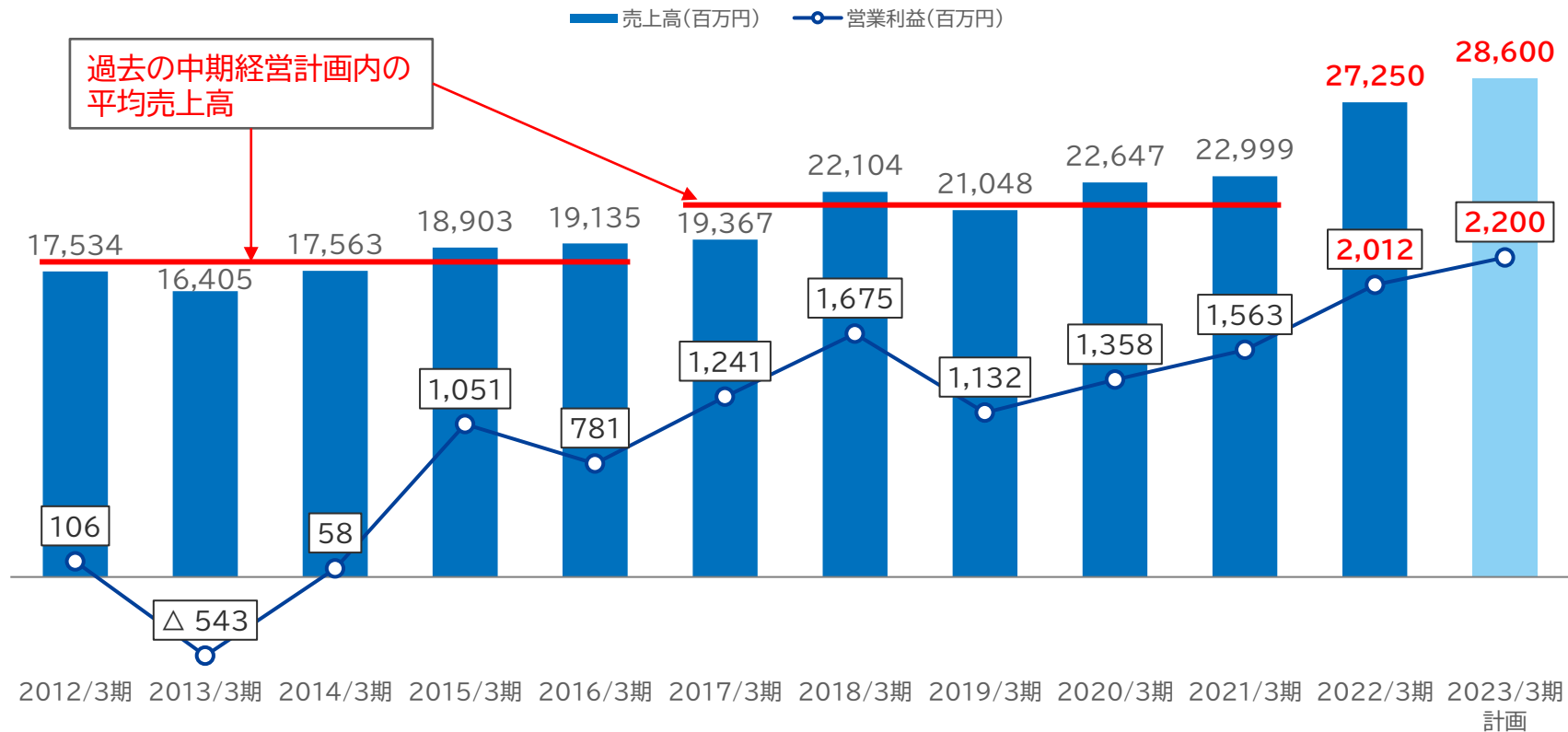
オプト用リードフレーム

売上高 3,686百万円
前同比 39.7%
構成比 13.5%



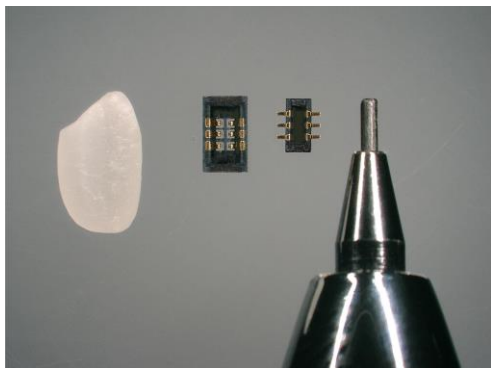
- 2021年3月期までの5年間は、スマートフォン向けの狭ピッチコネクタ等の成長により売上高200億円前後・営業利益も15億円前後に
- 2022年3月期は売上高272億円、営業利益20億円(過去最高)に達し新たなステージへ

売上高・営業利益の推移



1

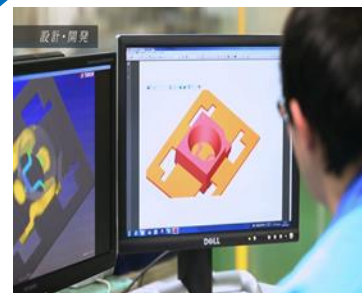
金属と樹脂の複合加工技術力



技術力

2

高品質・大量生産体制を支える
生産技術力



3

海外でも日本品質の生産体制



フィリピン



中国

一貫生産

4

独立系としてのサービスポジション

材料メーカーや
協力会社

幅広い顧客
ニーズ

最適な調達



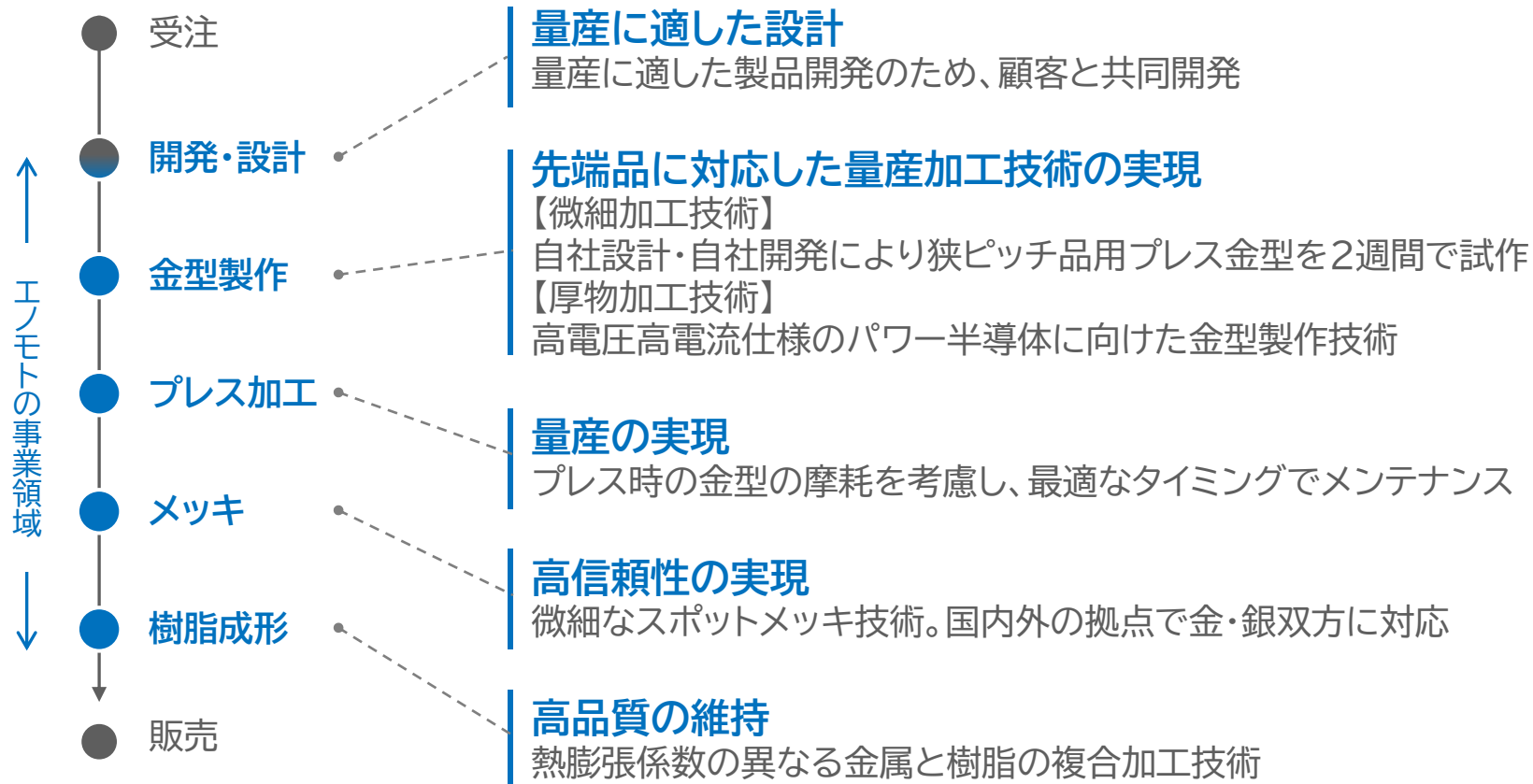
エノモト



柔軟な対応

特定の資本に縛られない
自由な営業方針

- ・ 強みである金型の設計・開発、プレス加工の技術を活かし、生産に特化
- ・ スマートフォン向けなどの狭ピッチコネクタ、パワー半導体用リードフレームの精密加工に強み
- ・ クリップボンディングリードフレーム、狭ピッチコネクタを大量生産できる企業は限られ、当社への受注が増加



(2) 2023年3月期第2四半期決算



- ・ 売上高増加要因はパワー半導体用リードフレームの好調と、円安による外貨売上の換算額増加(5.7%)
- ・ 経常利益はスマートフォン向けコネクタの前年上期の前倒し出荷の反動や、汎用リードフレームの出荷増による製品ミックスの変動と、生産能力増強に伴う減価償却費、人件費等の増加とエネルギー価格上昇により3.3%減益

	2022/3期 2Q累計		2023/3期 2Q累計		期比較	
	実績 (百万円)	売上比 (%)	実績 (百万円)	売上比 (%)	前年同期比 (%)	売上比増減(pt)
売上高	13,714	100.0	14,650	100.0	+6.8	-
売上総利益	2,283	16.7	2,173	14.8	△4.8	△1.8
販管費	1,132	8.3	1,234	8.4	+9.0	+0.2
営業利益	1,151	8.4	938	6.4	△18.5	△2.0
為替差損益	△4	-	138	-	-	-
経常利益	1,166	8.5	1,127	7.7	△3.3	△0.8
当期純利益	848	6.2	778	5.3	△8.2	△0.9

- ・ パワー半導体用リードフレームの好調や円安により、1Q・2Qとも増収
- ・ 利益は前年同期比では減益だが、2022年3月期4Qを底に回復傾向

単位:百万円	2022/3期					2023/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	前同比	1Q比
売上高	6,866	6,848	6,992	6,543	27,250	7,243	7,406	+8.2	+2.2
売上総利益	1,196	1,086	1,143	1,035	4,462	1,155	1,017	△6.4	△12.0
販管費	553	579	659	657	2,449	619	615	+6.3	△0.6
営業利益	643	507	483	377	2,012	536	401	△20.8	△25.1
為替差損益	△11	7	20	19	34	84	53	-	-
経常利益	639	526	538	349	2,054	638	489	△7.0	△23.3
四半期純利益	482	365	372	324	1,545	431	346	△5.3	△19.7

- ・ パワー半導体用リードフレームは、自動車や産業機器向けを中心に好調を継続
- ・ オプト用リードフレームは、中国ロックダウンの影響で、交通インフラや自動車向けのLED需要は前期並み
- ・ コネクタ用部品は、ウェアラブル端末向けは市場が拡大したが、スマートフォン向けは前年モデルの前倒し出荷の反動で低成長

単位:百万円	2022/3期						2023/3期				
	1Q	2Q	上期 累計	3Q	4Q	下期 累計	1Q	2Q	上期 累計	前同比	前下比
パワー半導体用 リードフレーム	2,380	2,309	4,690	2,592	2,646	5,238	2,684	2,797	5,481	+16.9%	+4.6%
オプト用 リードフレーム	969	921	1,891	878	916	1,795	1,008	931	1,940	+2.6%	+8.1%
コネクタ用部品	3,320	3,440	6,761	3,353	2,840	6,194	3,408	3,496	6,905	+2.1%	+11.5%
その他	195	176	371	166	141	307	143	180	323	△13.1%	+5.2%
合計	6,866	6,848	13,714	6,992	6,543	13,536	7,243	7,406	14,650	+6.8%	+8.2%

※今年度より製品分類を一部変更し、「パワー半導体用リードフレーム」と「その他」の間で 数値の組み換えを行いました。前年度は組み換え後の数値を記載しております。

- ・ 車載向けはパワー半導体用リードフレームが好調
- ・ スマートフォン向けは前年モデルの立ち上がりが早かった反動、ウェアラブル向けは新モデル向けが好調
- ・ 民生・産機・その他向けはデータセンター向け等のパワー半導体用は好調、LED用が減速

民生・産機・その他

- ・ 構成比は前年同期の36.7%から 2.5pt減少
前年同期比6.5%減少
- ・ データセンターや5G向けパワー半導体用リードフレームは好調継続
- ・ 交通インフラ等のディスプレイ向けLED用リードフレームが減速

ウェアラブル

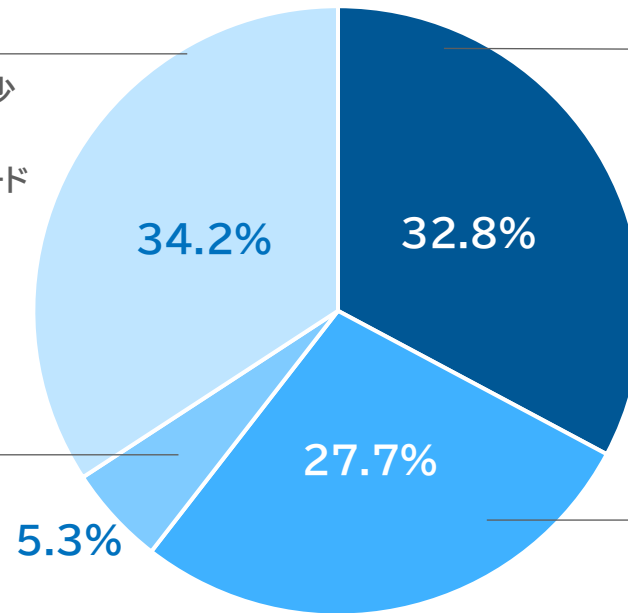
- ・ 構成比は前年同期の2.4%から 2.9pt増加
前年同期比118.9%増加
- ・ 新モデル向け中心に需要拡大、搭載個数も増加

車載

- ・ 構成比は前年同期の30.3%から 2.5pt増加
前年同期比8.4%増加
- ・ パワー半導体用リードフレームが好調
- ・ 自動車生産減少により、エアバッグ用コネクタ等が減少

スマートフォン

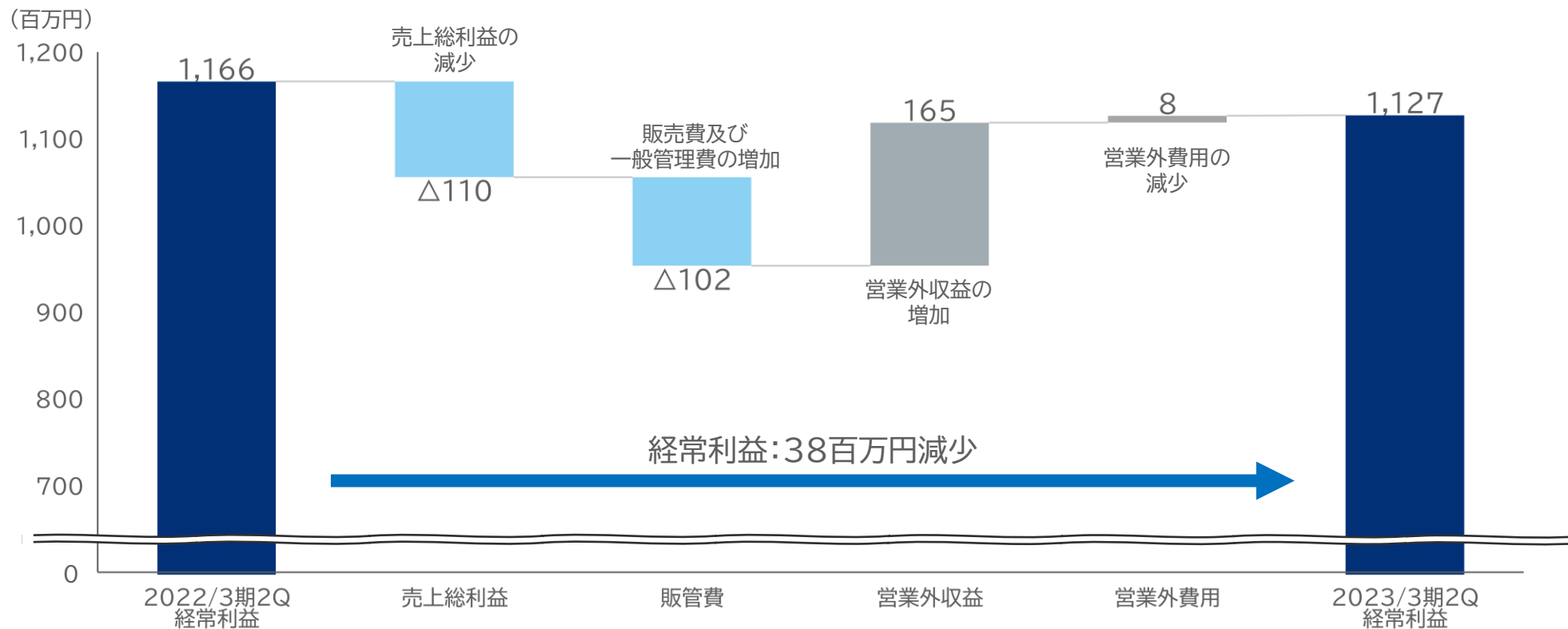
- ・ 構成比は前年同期の30.6%から 2.9pt減少
前年同期比9.7%減少
- ・ 前年モデルの立ち上がりが早かった反動、前年度下期比では回復



- 売上総利益の減少
 - … ①製品ミックスの変動と、生産能力増強に伴う減価償却費、人件費等の増加
 - ②エネルギーコスト上昇による電力費の増加

- 販売費及び一般管理費の増加
 - … ① 売上高の増加に加え、物流価格の高騰等による経費の増加
 - ② 人件費、開発費用の増加

- 営業外利益の改善
 - … 為替差益の増加等



(3)2023年3月期業績予想



- ・ パワー半導体向けを中心とするリードフレームが牽引し、売上高は286億円を予想
- ・ 期初計画を継続するが、下期に向けてはスマートフォンの販売や自動車生産の回復動向がリスク要因

	2022/3期			2023/3期			期比較	
	上期実績 (百万円)	通期実績 (百万円)	売上比 (%)	上期実績 (百万円)	通期予想 (百万円)	売上比 (%)	前期比 (%)	売上比増減 (pt)
売上高	13,714	27,250	100.0	14,650	28,600	100.0	+5.0	-
売上総利益	2,283	4,462	16.4	2,173	4,650	16.3	+4.2	△0.1
販管費	1,132	2,449	9.0	1,234	2,450	8.6	+0.0	△0.4
営業利益	1,151	2,012	7.4	938	2,200	7.7	+9.3	+0.3
経常利益	1,166	2,054	7.5	1,127	2,200	7.7	+7.1	+0.2
当期純利益	848	1,545	5.7	778	1,650	5.8	+6.8	+0.1
1株当たり 純利益		230.5円	-		247.4円	-	-	-

- ・ パワー半導体用リードフレームは自動車や産業機器向けなどの伸長により増収を予想
- ・ オプト用リードフレームは、中国市場の調整から減少の予測
- ・ コネクタ用部品はウェアラブル端末向けの伸長や自動車向けの回復を予想するが、マクロ景気減速によるスマートフォン販売や、自動車生産の回復動向がリスク要因

	2022/3期			2022/3期			
	上期実績 (百万円)	通期実績 (百万円)	構成比 (%)	上期実績 (百万円)	通期予想 (百万円)	構成比 (%)	前期比 (%)
パワー半導体用 リードフレーム	4,668	9,929	36.4	5,481	11,000	38.5	+10.8
オプト用 リードフレーム	1,891	3,686	13.5	1,940	3,400	11.9	△7.8
コネクタ用部品	6,761	12,955	47.5	6,905	13,700	47.9	+5.8
その他	393	679	2.5	323	500	1.7	△26.4
合計	13,714	27,250	100.0	14,650	28,600	100.0	+5.0

(4) 中期経営計画の進捗





社是

心技一体

経営理念

経営の中心は人であり、
健全なものづくりを通じて、
豊かな社会の実現に貢献する。

ビジョン2030

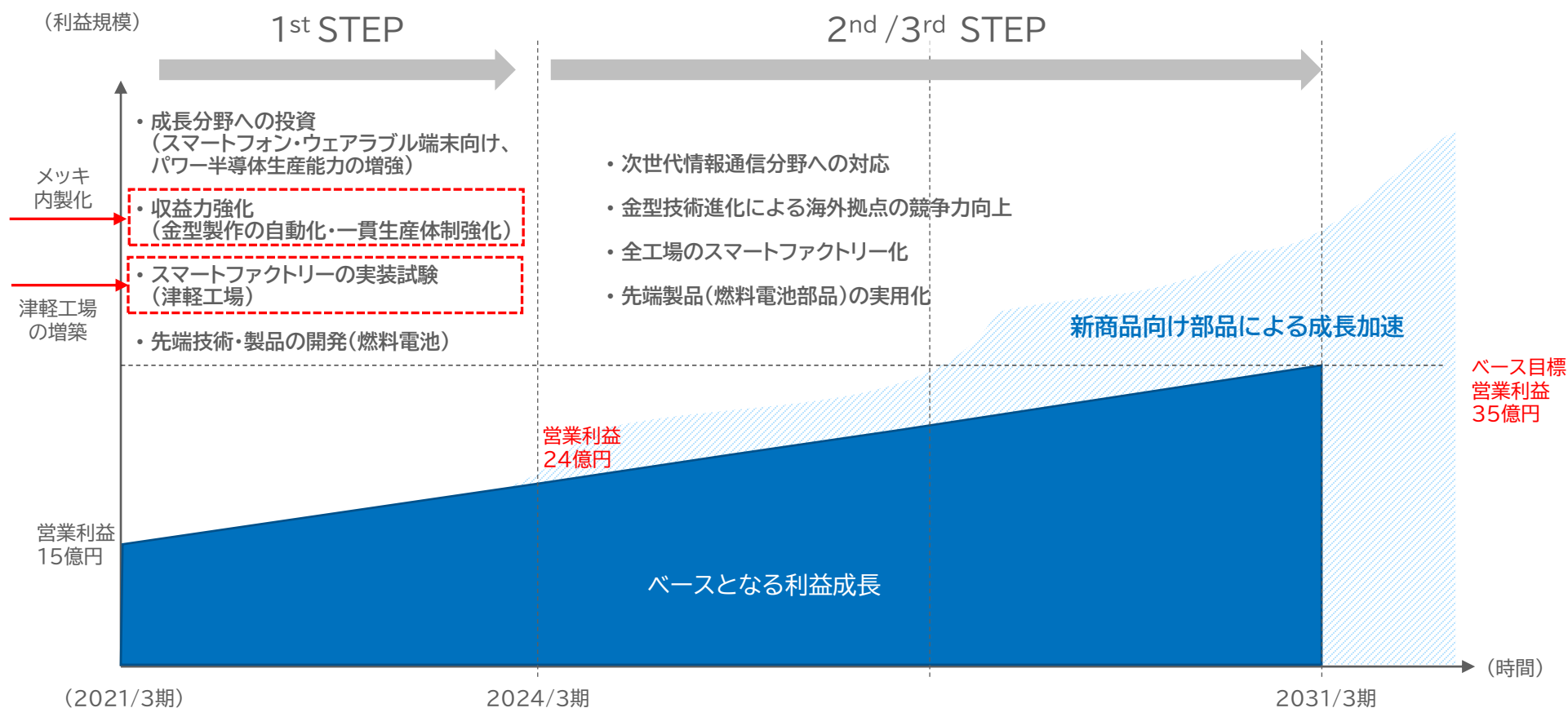
「金型の技術で未来を創る」

より小さく より速く 最先端の技術で
暮らしとビジネスのベストパートナーを目指す

ありたい姿

- 金型技術の進化で、最先端の市場に高品質な部品をスピーディに提供し続ける
- 失敗を恐れずチャレンジする職場環境づくりを通じてイノベーションを生み出す
- 燃料電池部品の実用化で脱炭素社会の実現に貢献する

- ・ ビジョン2030では、既存製品の需要拡大を見据えつつ、付加価値率の向上を軸とした各種施策で主力製品のマーケットの成長を上回る利益成長を図る
- ・ 2nd STEPで計画していたパワー半導体生産能力の増強を1st STEPに前倒して実施
- ・ 津軽工場と中国新工場でメッキ工程の内製化を行い付加価値を取込み

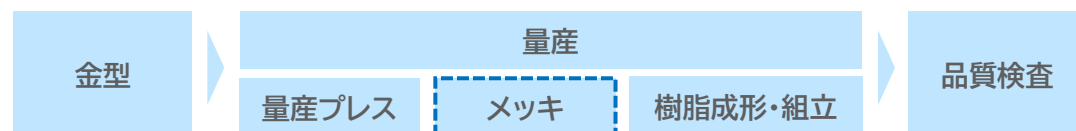


- 一貫生産体制強化のため、メッキ加工の内製化を進め、コネクタやリードフレームで付加価値向上を図る

津軽工場の新ライン



当社製品の主な製造工程



メッキの内製化でリードフレームとコネクタ製造の
全工程がほぼ内製化

さらなる付加価値の強化を目指す

- 津軽工場で1ライン、中国新工場で4ラインのメッキラインを新設。2023年1-3月期から本格量産を計画
- 表面処理プロジェクト室を新設し、メッキ組織を強化

中国新工場



- 工場を増築。
2021年11月末に竣工し
2022年1月より本格稼働開始
- 作業の自動化・効率化に向けて
自動倉庫・AGV(無人搬送車)を導入

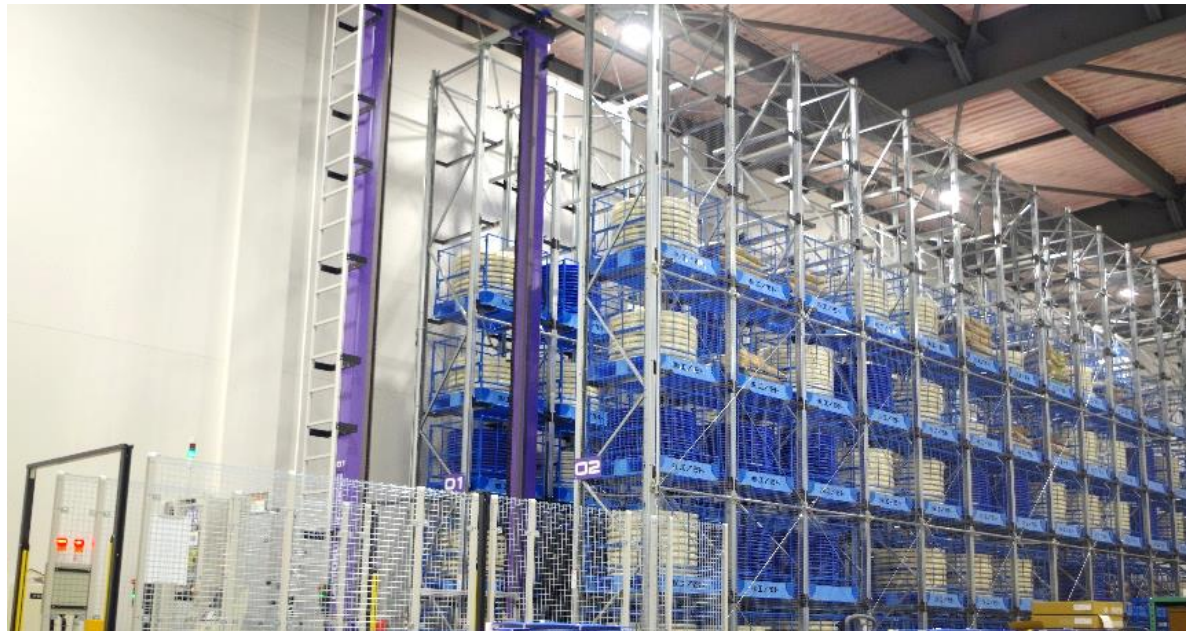


自動倉庫



運搬

製造現場



AGV (無人搬送車)



製品
材料
梱包用品
etc.

- スマートファクトリー実現に向けて、2022年4月に新ERPシステムへの切り替えを実施
- ビッグデータを構築し、AI活用した生産効率の向上や経営判断の迅速化につなげる

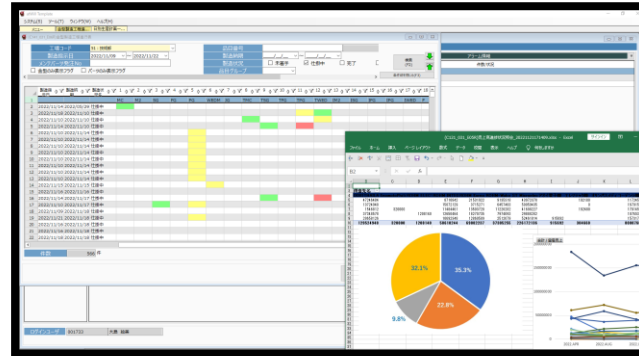
IoT活用

自動倉庫
AGV(無人搬送車)



見える化

高度な生産計画



ビッグデータの構築



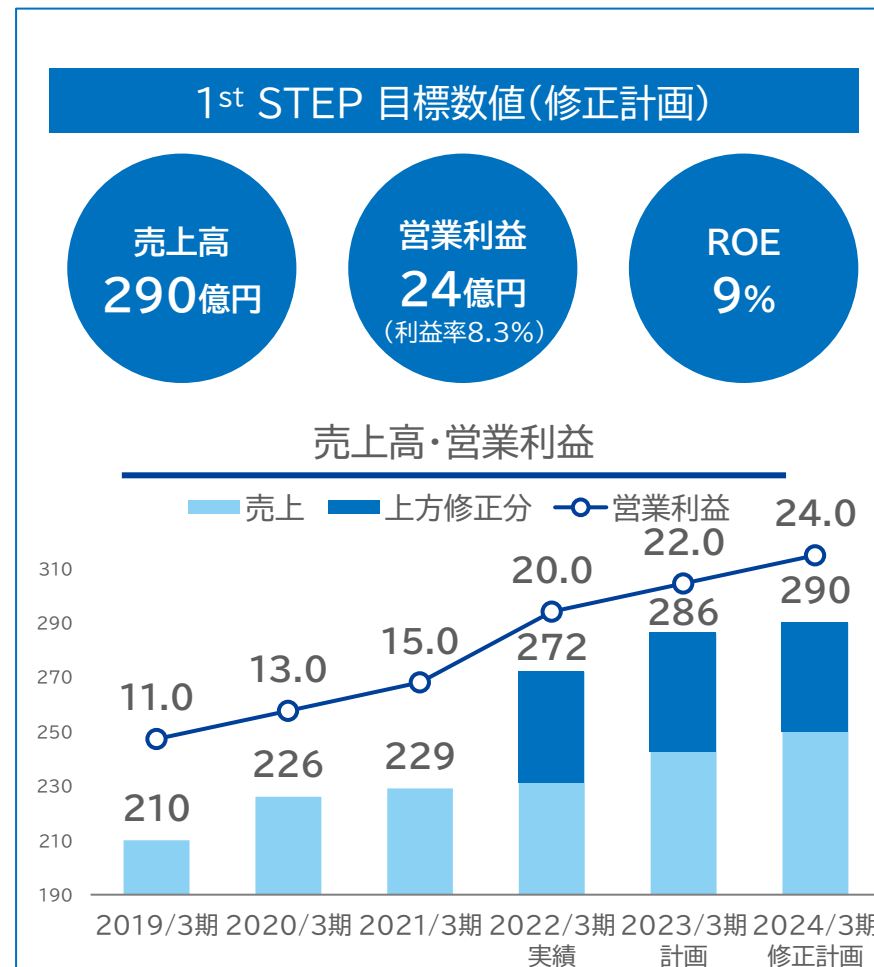
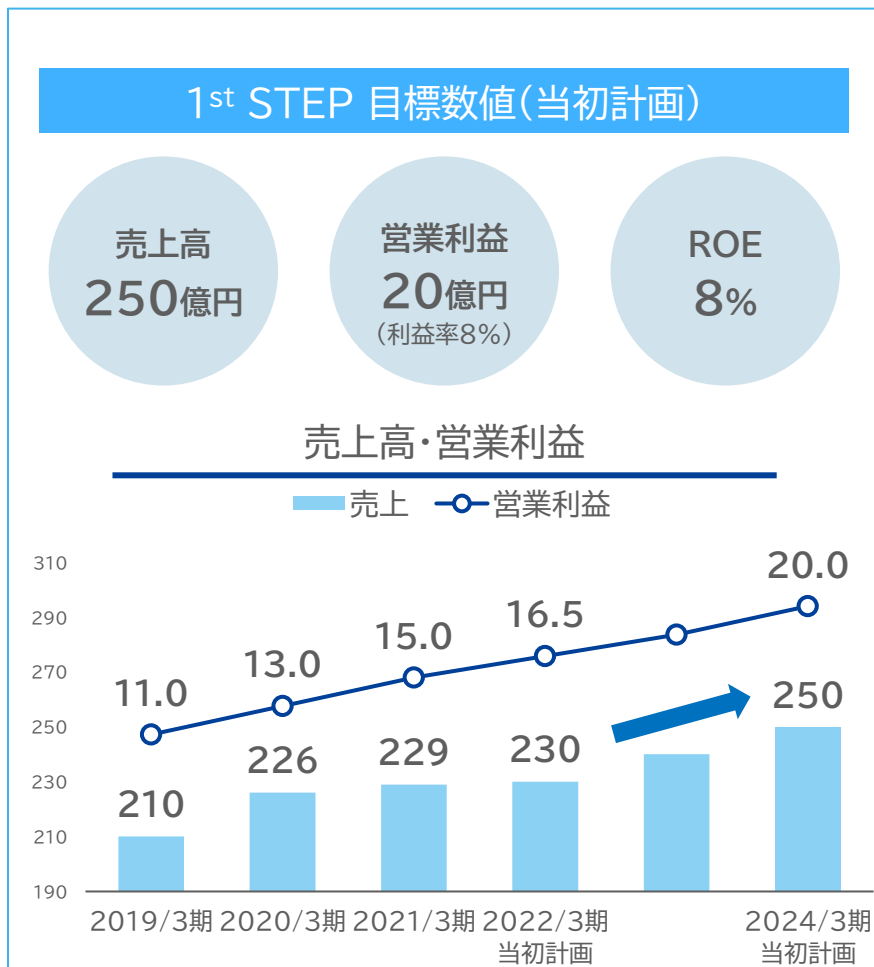
高度なスマートファクトリー
最適化・自動化



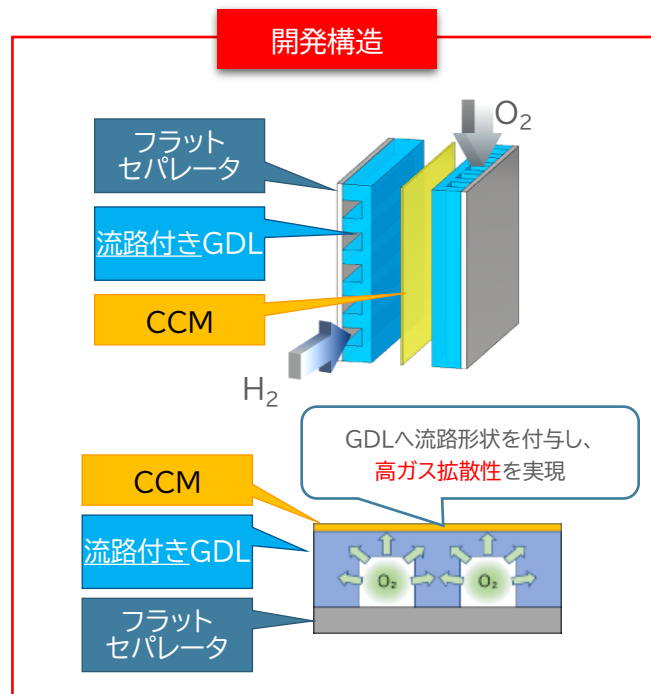
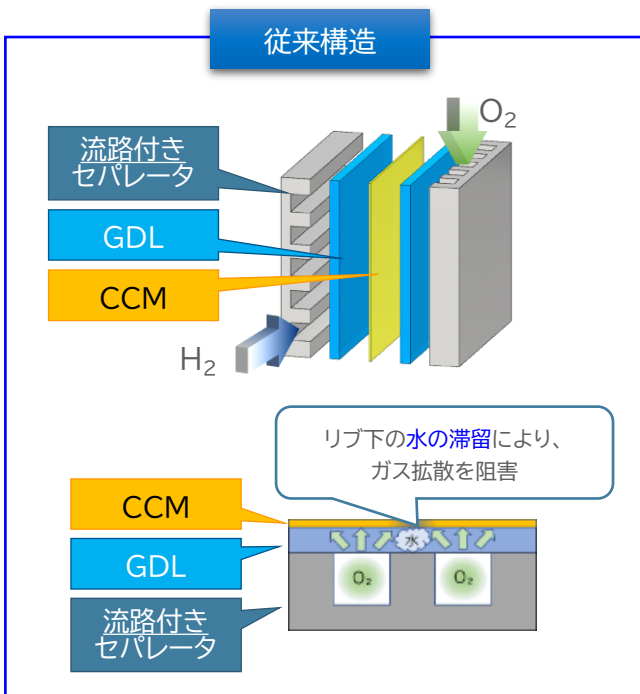
AIによる学習・分析



- 2022年3月期の**営業利益は中期経営計画の数値目標を達成**、2024年3月期(最終年度)は期初に24億円に修正
- パワー半導体向けリードフレームの生産能力を1st STEPに前倒して増強
- コネクタ用部品は、ウェアラブル端末向け中心に引き続き旺盛な需要が続く、津軽増築分の利益貢献も加速



- 固体高分子型燃料電池(PEFC)向けガス拡散層(GDL)一体型金属セパレータを山梨大学と共同開発
- 新開発の流路付きGDL(GDLFC+)で大幅な高電流密度化を実現、当社技術により汎用樹脂にガス流路を成形
- 金属セパレータ、GDLを自社生産し、ガスソケットと一体化し、コストを削減
- 2025年に燃料電池車向けのテスト開始、将来は電気自動車、ドローン、緊急電源、エネファーム等での実現を図る



2021年7月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)共通課題解決型産学官連携 研究開発事業に採択

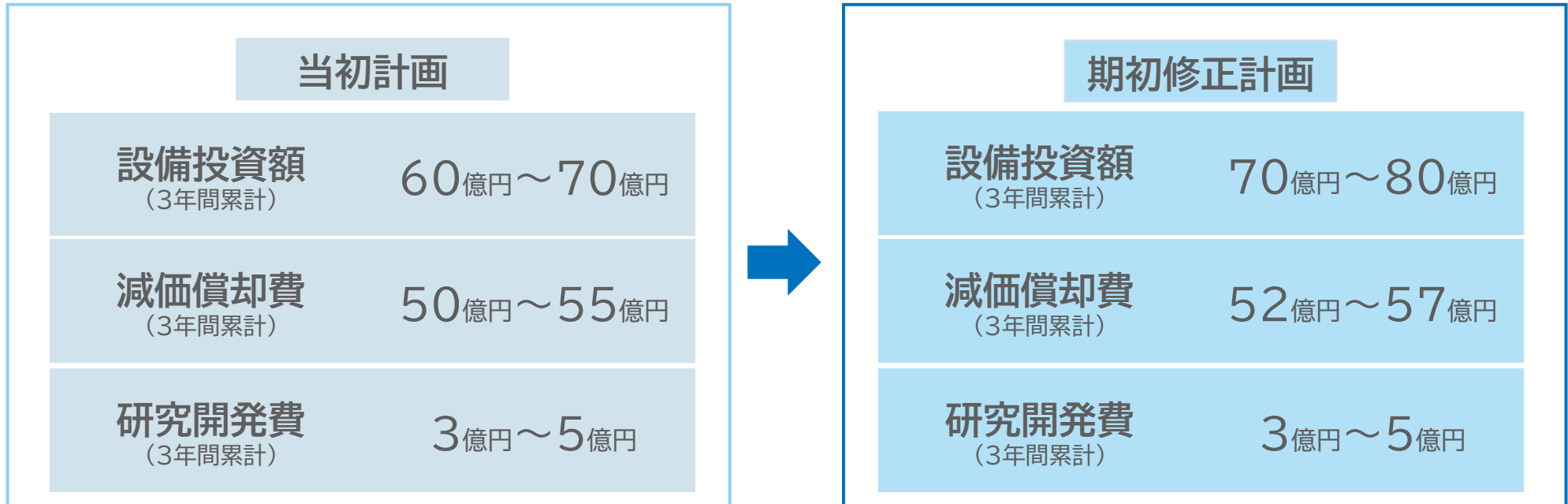
2022年11月

山梨大学及びスズキ株式会社と連名で寄稿した論文*がアメリカ電気化学会(ECS)にオープンアクセス版として掲載

GDLに対向櫛歯型流路(IDFF)を持つ新しい構造のセルが優れた酸素拡散性を持ち、従来のIDFFの課題である高加湿及び低加湿における出力低下の改善につながることを実証

* 「Improvement of PEFC Performance Stability under High and Low Humidification Conditions by Use of a Gas Diffusion Layer with Interdigitated Gas Flow Channels (対向櫛歯型流路が形成されたガス拡散層が固体高分子型燃料電池セルの高加湿および低加湿条件下における出力安定性の向上に及ぼす影響)」

- ・ 期初に、中期経営計画期間中の設備投資を60億円～70億円から、リードフレームの増産等により70億円～80億円に増額、これに伴い3年間の減価償却費も従来比2億円増加
- ・ 研究開発は計画通り進捗、当初計画から変更なし

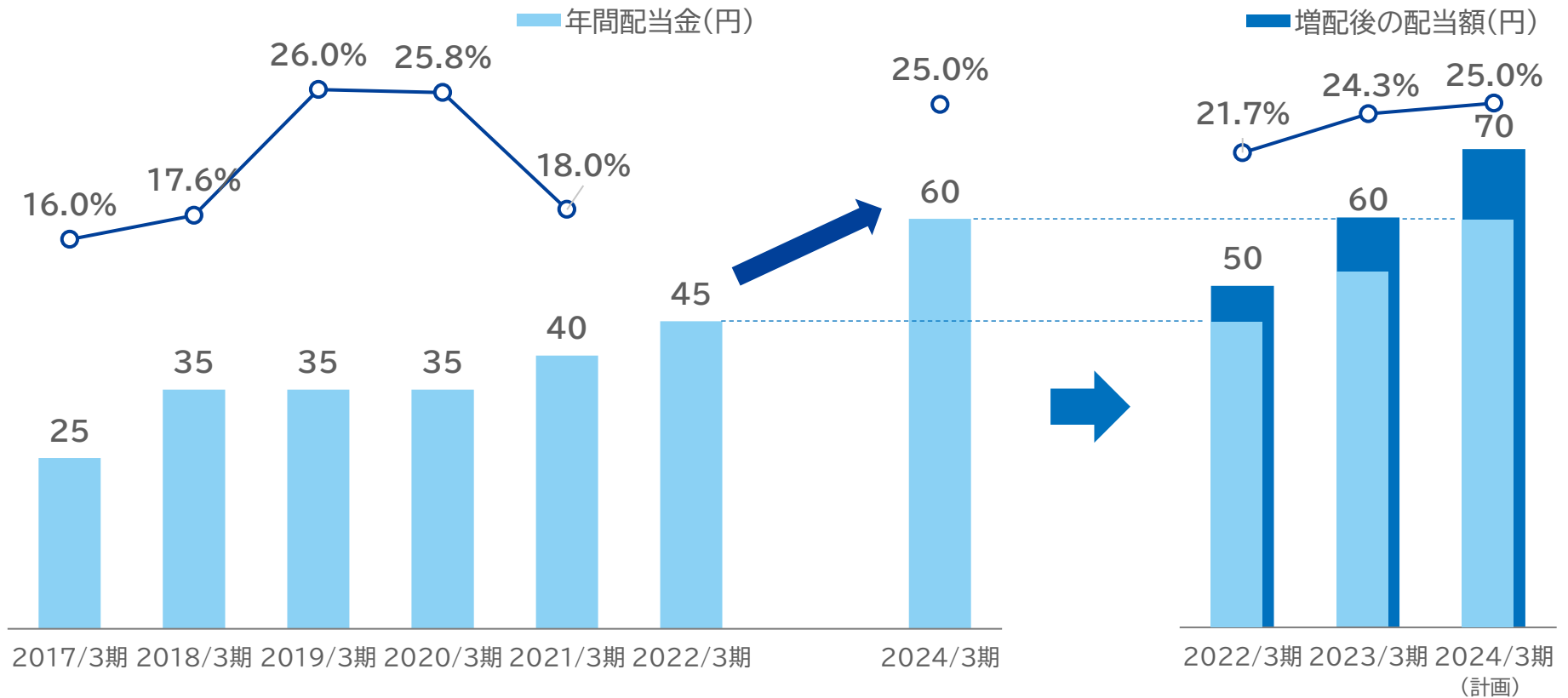


主要設備投資

- ・ メッキ工程内製化投資 9～10億円
- ・ 津軽工場増築 31億円 (スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタの増産)
- ・ パワー半導体用リードフレームの増産 10億円
- ・ スマートファクトリー化に向けたデジタル投資 5億円
- ・ 再エネ・省エネ投資 5億円

- ビジョン2030 1st STEPでは、津軽工場への投資等もあり、配当性向25%を目途に安定配当を継続
- 配当予想は期初計画を継続
2023年3月期は中計最終年度の**目標値60円を前倒しで計画**、**24年3月期は70円に増額**

配当金・配当性向の推移



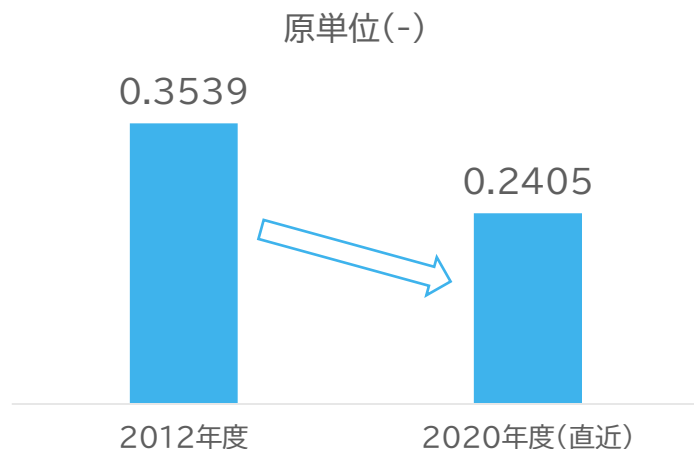
(5) 中期環境計画(SDGsへの取組み)



これまでの取組み

2012年比 **32%削減** エネルギー原単位*1

⇒ **業界目標*2を10年前倒しでほぼ達成済**



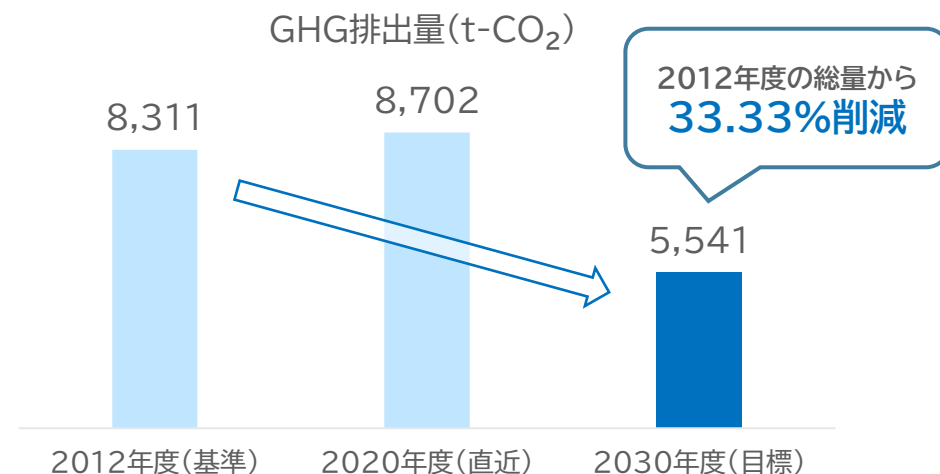
*1 エネルギー原単位 = $\frac{\text{エネルギー使用量(原油換算値)}}{\text{売上高}}$

*2 業界目標 電機・電子業界「低炭素社会実行計画」
2030年度エネルギー原単位 2012年度比 33.33%以上改善
参考資料:「電機・電子業界カーボンニュートラルに向けての取組み」
(2021年4月8日 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー小委員会)

これからの取組み

カーボンニュートラルに向けて目標のステップアップ
～原単位から、より厳しく総量削減へ～

- 生産プロセスにおけるGHG(温室効果ガス)排出量削減
再エネ活用と省エネ対策



- バリューチェーン全体のGHG排出量削減
- 社会全体のGHG排出抑制に貢献する技術開発
水素社会の実現(燃料電池部品の開発・実用化)
EVの普及・省エネへの貢献
(パワー半導体用リードフレームの拡販)
- 廃棄物・水・プラスチック使用量の削減

2030年度 目標

GHG排出総量 5,541 t-CO₂

GHG排出削減量 2,770 t-CO₂ {再エネ活用 1,400 t-CO₂
省エネ対策 1,370 t-CO₂

アクションプラン

1

再エネ活用

- ・ 津軽工場への太陽光発電設備の設置 (2023年1月完成予定)など
- ・ カーボンフリー電力の購入

GHG排出削減量 1,400 t-CO₂
2012年度比 16.85% 削減

化石燃料による
電力購入削減量 約3,400,000 kwh

2

省エネ対策

コンプレッサー

空調設備

照明機器

その他、生産設備

GHG排出削減量 1,370 t-CO₂
2012年度比 16.48% 削減

電力使用削減量 3,161,713 kwh

津軽工場へ太陽光発電設備の設置

- ・完成予定:2023年1月
- ・発電容量:約1.7MW
- ・年間発電量:約200万kWh(2023年度より)



(出所) GOOGLE MAP

特徴

- ・ 発電量は全て自家消費
- ・ 着雪対策
 - 太陽電池傾斜角度30°
 - 両面受光型太陽電池採用
- ・ 積雪・浸水対策
 - 太陽電池の最低地上高は1.5m
- ・ BCP対策
 - 蓄電池設置

GHG排出削減量:約1,044t-CO₂

参考情報

既存の太陽光発電設備



本社 (上野原)



フィリピン



本社 (塩山)



中国



本社 (塩山・屋根)

国内発電容量
約0.4MW

海外発電容量
約1.2MW

既存の発電容量:
国内海外合わせて
約1.6MW

津軽発電所完成後の発電容量:約3.3MW

津軽工場へ太陽光発電設備の設置



2022年11月29日時点

- 完成予定:2023年1月
- 発電容量:約1.7MW
- 年間発電量:約200万kWh
(2023年度より)

GHG排出削減量:約1,044t-CO₂



ご清聴ありがとうございました

参考資料



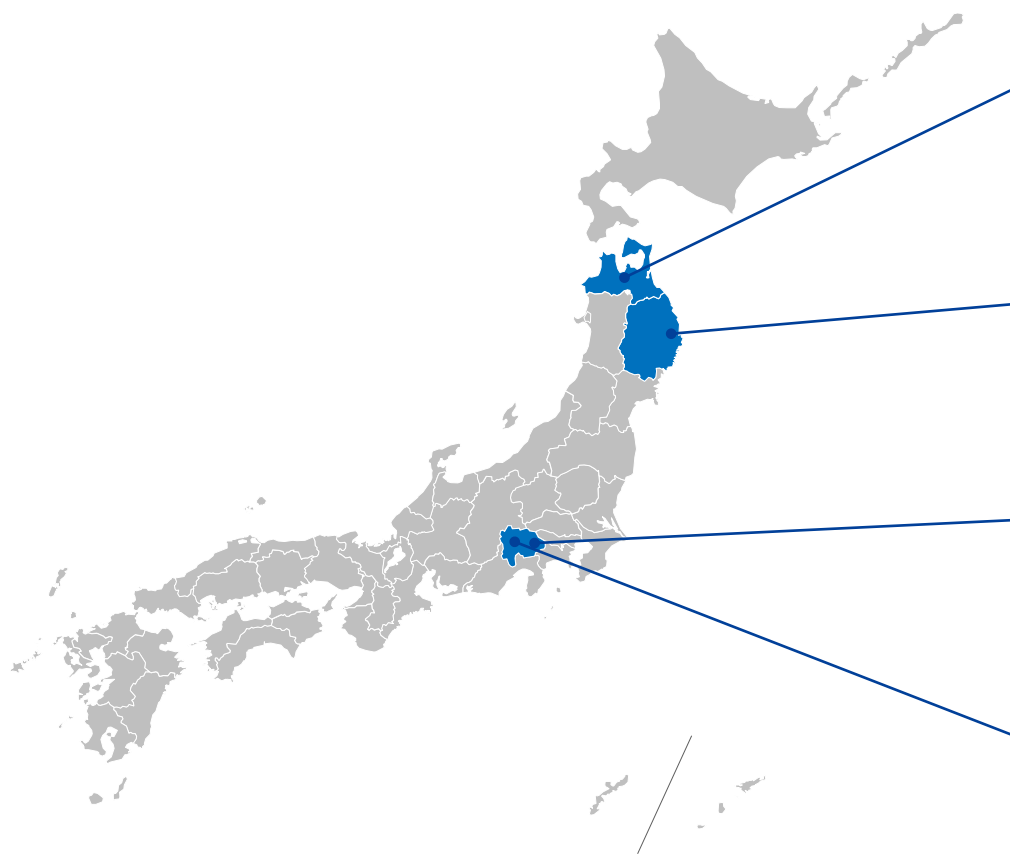
- 増収により売上債権が増加、津軽工場の増設などコネクタ部品等の増産投資により有形固定資産が増加

単位:百万円	2022/3期末	2023/3期2Q末	前年同期末差
流動資産	17,006	19,208	+2,202
（内、現預金）	4,365	4,498	+133
（内、受取手形及び 売掛金及び契約資産）	7,790	9,117	+1,327
固定資産	13,167	14,712	+1,545
（内、有形固定資産）	11,861	13,088	+1,227
総資産	30,174	33,921	+3,747
負債	11,545	13,249	+1,704
（内、有利子負債）	2,150	2,116	△34
純資産	18,628	20,671	+2,043
負債純資産	30,174	33,921	+3,747

- ・ 営業キャッシュフローは減益と円安に伴う外貨換算額の増加による棚卸資産の増加等で減少
- ・ 津軽工場の増築に伴う投資等により、フリーキャッシュフローは約1億円のマイナス

単位:百万円	2022/3期2Q累計	2023/3期2Q累計	前年同期未差
営業活動によるキャッシュフロー	1,815	1,137	△678
税引前当期純利益	1,159	1,123	△35
減価償却費	830	850	+20
棚卸資産の増加	△281	△538	△256
投資活動によるキャッシュフロー	△1,212	△1,233	△20
有形固定資産の取得による支出	△1,230	△1,203	+27
財務活動によるキャッシュフロー	206	△255	△461
長期借入れによる収入	500	0	△500
長期借入金の返済による支出	△49	△133	△84
配当金の支払い額	△272	△204	+67
現金及び現金同等物の期末残高	4,292	4,498	+205
フリーキャッシュフロー	603	△96	△699

- スマートフォンやウェアラブル端末の需要増加に対応するため、津軽工場を増築し、狭ピッチコネクタの生産能力を増強、5年間の投資額は31億円を計画
- リードフレームはパワー半導体向けなど高電圧・高電流対応品の生産体制を強化



津軽工場

主要生産品目

スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタ



岩手工場

主要生産品目

車載向け受動部品

スマートフォン向けコネクタ



本社工場(上野原)

主要生産品目

オプト用リードフレーム

リレー部品



本社工場(塩山)

主要生産品目

IC・トランジスタ向けリードフレーム

オプト用リードフレーム

- 中山工場(中国)では、リードフレームやコネクタ部品を、金型製作から組み立てまで一貫生産、パワー半導体向けのクリップボンディングリードフレームを量産
- フィリピン工場では、車載向けのコネクタ部品などを、金型製作から樹脂成形まで一貫生産、主に日系の東南アジア拠点向けに販売

中国



営業拠点 **ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd**
生産拠点 **ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.**
主要生産品目 IC・トランジスタ用リードフレーム
スマートフォン向けコネクタ部品

フィリピン



生産拠点 **ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.**
主要生産品目 エアバッグ向け大型コネクタ部品
車載向けスイッチ部品
IC・トランジスタ用リードフレーム

注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。